

# 【次世代パワーデバイスの本命】 ダイヤモンド半導体の開発動向と今後の期待

～応用範囲拡大とそのインパクト～

— 講 師 —

佐賀大学大学院 教授 嘉数 誠 氏

日 時 2025 年 6 月 2 4 日 (火) 午後 3 時～5 時  
受講方法 ライブ配信／アーカイブ配信 (2 週間、何度でもご視聴可)

## 〔重点講義内容〕

ダイヤモンドは、極めて高い絶縁破壊電界、高キャリア移動度、優れた熱伝導率を兼ね備えた、パワー半導体材料として理想的な特性を持つ素材です。最近、我々の研究により、インチ径の大口径ダイヤモンドウエハと半導体素子の製造に成功し、実用化への道筋が見えてきました。

本講演では、ダイヤモンドの物性がもたらす技術的優位性から、大口径結晶成長や素子製造技術、さらには高周波対応など最新の研究成果、今後の展望や産業応用への可能性について解説します。

1. ダイヤモンドの優れた物性
2. 大口径ダイヤモンドウエハの結晶成長技術
3. パワー半導体素子の作製技術
4. 高周波パワー半導体素子の作製技術
5. 今後の課題
6. 質疑応答

## PROFILE 嘉数 誠(かすう まこと)氏

1990 年 京都大学大学院博士課程修了、日本電信電話株式会社入社(基礎研究所配属)

2002-2003 年 独・ウルム大学客員研究員

2011 年 佐賀大学大学院 教授(パワー半導体)着任 現在に至る

|        |                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●受講料   | 各受講方法 1名につき <b>33,550円</b> (税込)<br>同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 <b>27,500円</b> (税込)<br>※会場又はライブ配信受講者様で、アーカイブ配信もご希望の場合は追加料金 <b>11,000円</b> (税込)で承ります。                                          |
| ●お申込方法 | 二次元バーコード、又は FAX にてお申し込み下さい。<br>折返し受講証、請求書をメール(PDF)にてお送りいたします。<br>お申込み後、3営業日以内にお手元に届かない場合は必ずご一報下さい。<br>※お客様のご都合でキャンセルされる場合は、「 <b>開催1週間前まで</b> 」にお申し出下さい。<br>その後のキャンセルは、お申し受けできませんのでご了承下さい。 |
| ●お支払方法 | 請求書を発行いたしますので、開催日までに銀行振込でお願いします。(遅れる場合はご相談下さい)                                                                                                                                            |

事前に、セミナー講師へのご期待、ご要望、ご質問をお受けしております。  
可能な限り講義に盛り込んでいただきますので、お申し込み後、弊社からご連絡するメールにご返信ください。

■**ライブ配信について**  
<1>Zoomにてライブ配信致します。  
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用 URL と ID・PASS を開催前日までにお送り致しますので、開催日時に Zoom へご参加ください。

■**アーカイブ配信について**  
<1>開催日より3～5営業日後を目安に Vimeo にて配信致します。  
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、視聴用 URL をお送り致します。  
<3>動画は配信日より2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。

|                                                      |                           |                     |         |           |   |   |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|-----------|---|---|
| 6月24日(火)                                             |                           | 「ダイヤモンド半導体の開発動向と期待」 |         | 申込日       | 月 | 日 |
| 貴社名                                                  |                           |                     |         |           |   |   |
| 所在地                                                  | 〒<br>〇印をお付けください(ご自宅・お勤め先) |                     |         |           |   |   |
| いずれかの□に必ず✓をお入れ下さい。(アーカイブ配信の追加受講をご希望の場合は、2つ☑をお入れ下さい。) |                           |                     |         |           |   |   |
| □ ライブ配信                                              |                           |                     |         | □ アーカイブ配信 |   |   |
| フリガナ氏名                                               |                           |                     | 所属部署・役職 |           |   |   |
| TEL                                                  | ( ) -                     |                     | FAX     | ( ) -     |   |   |
| E-mail                                               | ブロック体でのご記入をお願いいたします。      |                     |         |           |   |   |

|                                                      |                      |  |         |           |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------|--|---------|-----------|--|--|
| ※複数名様お申込の場合は下記にご記入をお願いいたします                          |                      |  |         |           |  |  |
| いずれかの□に必ず✓をお入れ下さい。(アーカイブ配信の追加受講をご希望の場合は、2つ☑をお入れ下さい。) |                      |  |         |           |  |  |
| □ ライブ配信                                              |                      |  |         | □ アーカイブ配信 |  |  |
| フリガナ氏名                                               |                      |  | 所属部署・役職 |           |  |  |
| TEL                                                  | ( ) -                |  | FAX     | ( ) -     |  |  |
| E-mail                                               | ブロック体でのご記入をお願いいたします。 |  |         |           |  |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ※「受講証」等の送付先が上記と異なる場合は下記にご記入下さい。 |  |
| 通信欄                             |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ●E-mail アドレス登録受付 & ご紹介キャンペーン実施中[Amazon ギフト券(500円)を進呈いたします]                                                                                                                                                 |  |
| □セミナーへのお申込みではなく、メール配信登録のみの方は左記へ✓を入れて下さい。<br>※携帯アドレス、フリーメールアドレスは登録対象外となっております。<br>※メール配信登録をご希望の方をご紹介下さい！ご紹介いただいた方には Amazon ギフト券(500円)を進呈させていただきます。<br>※上記お申込フォームに、ご登録情報(貴社名・所在地・氏名・所属部署・役職・メールアドレス)をご記入下さい。 |  |

詳細・お申込はこちら↓

■主催(お申込み・お問い合わせ先) 株式会社 新社会システム総合研究所

お申込み受付 FAX 03-5532-8851



〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4階  
Tel:03-5532-8850 / E-mail:info@ssk21.co.jp / URL:https://www.ssk21.co.jp  
※配信停止、宛先変更、個人情報の苦情及び相談・開示は上記までご連絡下さい。

25275-I